



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «ЛионТех»

196247, Россия, Санкт-Петербург,

Ленинский проспект, д. 153, лит. А, офис 906 (этаж 9)

Тел./Факс: +7 (812) 309-27-37, +7 (495) 646-14-76

E-mail: mail@liontech.ru www.liontech.ru



РасТех

member of nagase group

Немецкая компания Packaging Technologies GbmH (РасТех) является мировым лидером по разработке и производству оборудования для производства микроэлектроники. Главными направлениями деятельности компании РасТех являются:



Разработка и производство передового оборудование для корпусирования:

- Бесконтактный монтаж шариков припоя, бесконтактная лазерная пайка шариками припоя по запатентованной технологии SB2 (Solder Ball Bumping);
- Восстановление и повторное нанесение шариков припоя (боллинг и реболлинг);
- Монтаж шариков припоя на пластины (бампинг пластин и кристаллов);
- Сборка изделий, монтаж кристаллов и компонентов методом лазерной пайки (флип-чип монтаж, вертикальный монтаж кристаллов);
- Линии для бампинга пластин методом химического осаждения металлов;
- Оборудование для сборки изделий фотовольтаики и солнечных модулей по индивидуальным требованиям заказчика.



Звонок по России бесплатный:

Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ООО «ЛионТех»

196247, Россия, Санкт-Петербург,

Ленинский проспект, д. 153, лит. А, офис 906 (этаж 9)

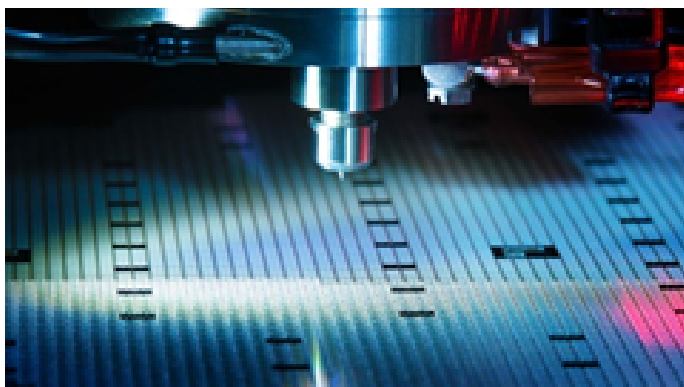
Тел./Факс: +7 (812) 309-27-37, +7 (495) 646-14-76

E-mail: mail@liontech.ru www.liontech.ru



Поставка химических процессов «под ключ»

- Очистка поверхности алюминиевых и медных контактных площадок на планарной стороне пластины;
- Активация поверхности алюминиевых и медных контактных площадок на планарной стороне пластины;
- Химическое нанесение никеля, палладия, серебра и меди;
- Иммерсионное нанесение золота и серебра;
- Применение цианидных и бесцианидных электролитов и растворов;
- Специальные решения для очистки и активации контактных площадок из серебра и никеля;
- Фоторезисты и растворители.



Услуги по технологии сборки на пластине (WLP – Wafer Level Packaging)

- Гальваническое и химическое осаждение металлов на полупроводниковые пластины;
- Монтаж шариков припоя (бампинг);
- Металлизация обратной стороны пластин;
- Репассивация пластин;
- Утонение и резка пластин;
- Другие Back-End процессы.

Компания «ЛионТех-С» является официальным дистрибьютором оборудования PacTech на территории Российской Федерации.

